

苏州国芯科技股份有限公司

2025 年 7 月 7 日至 11 日投资者关系活动记录表

证券简称：国芯科技

证券代码：688262

编号：2025-017

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	银华基金；银河证券；上证自营；上银基金；中信建投资管；中信资管；中银资管；兴业基金；兴全基金；兴银理财；创金合信基金；华夏久盈；华夏基金；华夏未来资管；华福资管；同泰基金；国信证券资产管理；国寿安保基金；国寿安保基金；国投瑞银基金；天治基金；太平基金；宏利基金；宏道投资；宝盈基金；富国基金；平安基金；幸福人寿；广发基金；朱雀基金；标朴资产；汇添富基金；汐泰投资；江信基金；泰信基金；淳厚基金；财通资管；金友创智；鑫元基金；钦沐资产；远希私募基金；银河基金；长安基金；长江资管；鹏华基金；中泰证券。
时间	2025 年 7 月 7 日；2025 年 7 月 8 日；2025 年 7 月 11 日
地点	现场交流及线上交流
上市公司参加人员姓名	董事长：郑茳 董事会秘书：龚小刚
投资者关系活动主要内容介绍	1、请介绍一下公司今年研发和产业应用工作的重点是什么？ 答：在新技术新产品研发方面，公司将继续坚持创新驱动的发展理念，高度重视 RISC-V 指令架构 CPU 研发工作，重点注重研发汽车电子芯片、信创与信息安全芯片等重点产品，积极发展端/边缘侧 AI 技术和量子安全相关技术。研发进展主要包括：在汽车电子芯片方向，

	公司聚焦国内空白领域，对标国际领先芯片技术，不断实现突破。经过研发人员的不懈努力，公司完成了面向下一代 48V 电子电气架构的汽车电子安全气囊点火芯片 CCL1800B 的研发，这是业界首次成功研发的同类产品。2025 年，公司 CCD5001、CCD4001 和 CCD3001 系列 DSP 芯片进入量产，可与 ADI ADSP-2156x 进行硬件管脚兼容和规格对标，已有多个头部车厂的座舱主机和独立功放项目进行应用开发及测试。公司采用多核高性能 RISC-V 架构正在设计的 CCFC3009PT 芯片对标英飞凌 TC4XX 系列芯片，有望实现对目前在智能座舱和自动驾驶领域大量应用的英飞凌 TC397、TC49X 和瑞萨 U2B 系列芯片的国产化替代，具有国际先进水平。在云安全芯片领域，公司上半年成功推出了极高性能云安全芯片 CCP917T，该芯片 SM2 签名效率达到 100 万次/秒，对称算法 4KB 小包性能达到 80Gbps，CCP917T 具有行业先进水平，适用于人工智能、云计算安全、网络安全和运营商核心网应用。目前，该芯片正在多家国内头部客户开发应用中。在抗量子密码和量子安全芯片领域，今年以来，公司先后完成了抗量子密码芯片 AHC001 和抗量子密码卡 CCUPHPQ01 的研发工作，目前公司已经向多家客户送样进行应用开发。2025 年初，经过公司与问天量子成立的“量子芯片联合实验室”协同攻关，成功推出了量子安全芯片 CCM3310SQ-T。 2025 年以来，公司积极推进自主芯片新技术新产品的市场应用工作，随着芯片应用面的持续扩大，云安全芯片在国内市场上占有较高的市场份额，汽车电子芯片销售收入已出现较快增长的局面，AI MCU 芯片产品在商用空调、婴儿看护、智能微波炉等领域实现产品量产，抗量子密码卡和量子安全芯片也开始实现客户应用。 说明：对于已发布的重复问题和内容，本表不再重复记录，更多关于公司的情况敬请查阅公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上披露的定期报告、临时报告及公司在上证 E 互动平台“上市公司发布”栏目刊载的各期《投资者关系活动记录表》。
附件清单 (如有)	无

日期	2025 年 7 月
----	------------